

令和 3年 3月 8日

NEDIA 会員各位

日本電子デバイス産業協会
材料部品部会 小林 関司

「第三十回勉強会」のご案内

向春の候 皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

早速ですが、非常事態宣言延長の関係で延期しておりました材料部品部会(旧 JAST 部会)主催の「第三十回勉強会」を下記の日程で開催することにいたしました。

2021年の年明けは、新型コロナの感染者増大、米中問題等の問題が継続しております。

我々の業界にどのような影響が出てくるのか予断を許さない状況になっております。このような状況の中で我々としては、現状をどう認識し今後どのように対応すればよいのかを勉強したいと思います。

今回の勉強会では、半導体産業の最新市況についてお話をさせていただきますので大勢の方のご参加をお待ちしております。

尚、開始時間が14:00 ですのでご注意ください。

— 記 —

日時 令和 3年4月15日(木曜日) 14:00-16:30

場所 御茶ノ水めっきセンター(4F) 03-3814-5621 (代)

東京都文京区湯島1-11-10 <http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html>

[スケジュール]

(1) 14:00~15:00 (60分)

講師 上田 弘孝氏/セミコンサルト代表

テーマ 「まだ道遠きミリ波5Gスマートフォンの現状!!」

休憩 15:00~15:15

(2) 15:15~16:30 (75分)

講師 津田 建二氏/セミコンポータル編集長

テーマ 「最新半導体産業の動向!!」

(新型コロナ禍、米中問題、企業買収、半導体ベンチャーの続出・・・)

(注1) 今回参加される方には、資料代として2,000円/人徴収いたします。(非会員の方には、資料代込みで5,000円)

(注2) 添付いたします出欠用紙での回答を、4月8日までにメールでお願いいたします。なお資料等の準備の関係で定員(40名)になり次第参加申し込みを締め切らせていただきます。

以上